## 附件1

技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位信息** | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 北京华清新能科技有限公司 | 社会统一信用代码 | 91110108MA004DD74L |
| 联系人 | | | | 胡永生 | 联系电话 |  |
| 行政区域 | | | | 省（自治区、直辖市）北京市（地） 市（县） | | |
| 是否在国家高新区内？ | | | | ☑是 （高新区名称）  □否 | | |
| 所属行业 | | | | 电力行业 | 技术领域 | 电路 |
| 上一年度  营业总收入 | | | | 2000（万元） | 人员总数 | 20（人） |
| 高新技术企业认定 | | | | ☑是 □否 | 科技型中小企业备案 | □是 □否 |
| **需求名称：多层电路板校准、结构问题** | | | | | | |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ☑技术研发（关键、核心技术）  □产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | |
| 需求  内容 | 由于[多层电路板](http://www.hqpcb.com/zhuoluye9)中层数众多，用户对[PCB](http://www.hqpcb.com/)层的校准要求越来越高。通常，层之间的对准公差控制在75微米。考虑到多层电路板单元尺寸大、[图形](https://data.hqchip.com:4006/t/yM)转换车间环境温湿度大、不同芯板不一致性造成的位错重叠、层间定位方式等，使得多层电路板的对中控制更加困难 | | | | |
| 现有  基础 | 开展了多项技术开发电路板研发，处于发展阶段。 | | | | |
| 产学研合作要求 | 简要  描述 | 希望与电路行业的顶尖公司，或者顶尖的学校开展合作，让我们的技术更加成熟，联合一起开发。 | | | | |
| 合作  方式 | □技术转让 ☑技术入股 ☑联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | | □是 □否  ☑部分公开（说明） | | | |
| 同意接受  专家服务 | | | ☑是  □否 | | | |
| 同意参与解决方案筛选评价 | | | □是  ☑否 | | | |
| 同意出资奖励优秀解决方案 | | | ☑是，金额2万元。（奖金仅用作鼓励挑战者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  □否  法人代表： 年 月 日 | | | |